

一零四資訊科技股份有限公司 函

地址：231新北市新店區寶中路119-1號10樓

承辦人：陳姿岑

電話：29126104

電子信箱：vien.chen@104.com.tw

受文者：國立嘉義大學

發文日期：中華民國115年4月8日

發文字號：一資字第2026404002號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：台灣應用材料_CE CST面談會_校園宣傳文案 (6404002A00_ATTCH1.pptx)

主旨：敬請貴校協助轉知理工科系應屆畢業生及校友有關台灣應用材料股份有限公司招募「客戶技術支援工程師／助理工程師」職缺資訊，請查照。

說明：

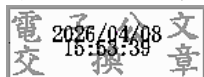
- 一、應用材料公司為全球領導之半導體與顯示器設備商，名列全球500大企業，其技術廣泛應用於先進晶片與AI產業發展，為推動全球科技創新的關鍵企業之一。
- 二、台灣應用材料股份有限公司深耕台灣，於全台各地設有研發、製造與全球技術培訓中心，提供完善培訓制度、國際化工作環境及具競爭力之薪資福利，並多次獲選為最佳雇主與永續企業，深受產業肯定。
- 三、本次由104人力銀行協助台灣應用材料強力招募「客戶技術支援工程師／客戶支援助理工程師」，主要負責半導體設備技術服務與客戶支援，適合理工相關科系畢業生投遞。近期預計舉辦三場招募面談會4/18、4/25、5/9，歡迎投遞履歷，審核通過者將由專人聯絡出席相關事宜。



四、附件為校園宣傳文案，敬請貴校協助透過電子郵件、校內公告及社群媒體等管道轉知應屆畢業生及校友，協助優秀人才把握進入國際級半導體企業之機會。

正本：國立政治大學、國立清華大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立中山大學、國立臺灣海洋大學、國立中正大學、國立高雄師範大學、國立彰化師範大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立東華大學、國立暨南國際大學、國立臺灣科技大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國立臺北科技大學、國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學、國立臺東大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、國立臺南大學、國立臺北教育大學、國立臺中教育大學、國立澎湖科技大學、國立勤益科技大學、國立金門大學、國立臺中科技大學、國立臺北商業大學、國立屏東大學、國立高雄科技大學、國立臺東專科學校、東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、中原大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學學校財團法人中華大學、大葉大學、華梵學校財團法人華梵大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、高雄醫學大學、南華大學、真理大學、大同大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、樹德科技大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、臺北醫學大學、中山醫學大學、龍華科技大學、輔英科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、長榮大學、弘光科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、玄奘大學、建國科技大學、明志科技大學、台鋼學校財團法人台鋼科技大學、大仁科技大學、聖約翰科技大學、嶺東科技大學、中國科技大學、中臺科技大學、亞洲大學、開南大學、佛光大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、中信金學校財團法人中信科技大學、景文科技大學、東南科技大學、德明財經科技大學、明道學校財團法人明道大學、南開科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、僑光科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、康寧學校財團法人康寧大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、亞東學校財團法人亞東科技大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、大漢學校財團法人大漢技術學院、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、黎明技術學院、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、臺北市立大學

副本：



總經理 黃于純